

# Intel et DoCoMo s'unissent dans la 3G

Intel, numéro un mondial des microprocesseurs vient de marquer un point important dans sa stratégie de conquête du marché de la mobilité. Le groupe américain vient d'annoncer une alliance avec DoCoMo, premier opérateur japonais de téléphonie mobile, dans le domaine des puces pour téléphonie mobile 3G.

Selon le quotidien économique japonais *Nihon Keizai Shimbun*, l'objectif de cet accord est de mettre au point d'ici quelques années des puces à faible coût et à faible consommation d'énergie capables de remplir plusieurs tâches différentes, comme la gestion de communications Internet et le traitement d'images. La faible autonomie des mobiles actuels de troisième génération empêche une utilisation confortable des services multimédias. Ce point négatif est surtout observé au Japon où la 3G est aujourd'hui une réalité. Par ailleurs, cet accord doit rendre le service 3G de DoCoMo plus compétitif, tandis qu'Intel espère gagner des parts de marché dans la téléphonie mobile où il est deuxième derrière Texas Instruments.